

# 日本の半導体産業・研究の 明るい未来を描く

## ー今がアイデア創出のチャンスー

材料・プロセス・デバイス／素子開発に携わる若手研究者は、  
今後どうあるべきか？

第65回応用物理学会春季学術講演会  
13. 半導体 分科企画シンポジウム  
日時: 3月19日(月) 13:00~17:20  
場所: 早稲田大学 63号館 G201

### 招待講演者(敬称略)

- 「(仮) イメージセンサの最新技術と今後の動向」  
閻 宏司 (ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社)
- 「日本のファウンドリビジネスの現状と未来」  
井桁 光昭 (三重富士通セミコンダクター株式会社)
- 「ルネサスが目指すソリューションビジネスとそれを実現するデバイス技術」  
大西 和博 (ルネサス エレクトロニクス株式会社)
- 「タイトル未定」  
岩本 邦彦 (ローム株式会社)
- 「次世代メモリ開発における材料/素子研究の役割」  
藤井 章輔 (東芝メモリ株式会社)
- 「More than Moore時代のデバイス開発イノベーション  
～微細ReRAMの研究開発から実用化開発に至るまで～」  
三河 巧 (パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社)
- 「SiCパワーデバイス研究開発の最新動向」  
野口 宗隆 (三菱電機株式会社)
- 「IoT時代に向けた半導体200mmラインの活用  
- NEDO 平成27年度 「国内半導体製造ラインの実態調査、及びその有効活用法の検討」 報告」  
入江 康郎 (みずほ情報総研株式会社)

世話人: 田岡紀之(AIST), 中塚理(名大), 牧原克典(名大), 入沢寿史(AIST)